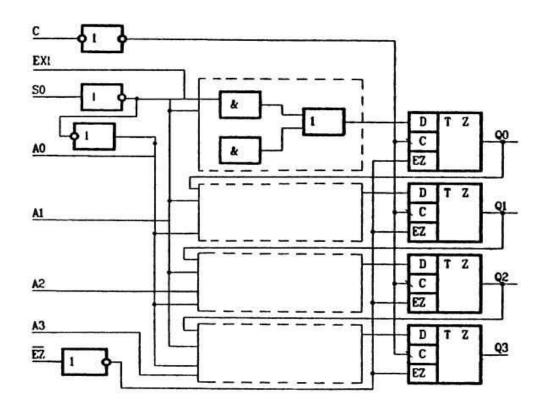
КР1533**ИР**16

Микросхема представляет собой 4-разрядный реверсивный сдвиговый регистр с параллельной записью и тремя состояниями на выходе. Обеспечивает 3 режима работы: параллельная загрузка, сдвиг вправо, сдвиг влево. Корпус типа 201.14-1, масса не более 1 г.



Функциональная схема КР1533ИР16

Назначение выводов: 1 - вход последовательного ввода данных EX1; 2...5 - информационные входы A0...A3; 6 - вход выбора режима S0; 7 - общий; 8 - вход управления третьим состоянием \overline{EZ} ; 9 - вход тактовый C; 10...13 - информационные выходы Q3...Q0; 14 - напряжение питания.

Электрические параметры

Номинальное напряжение питания	5 B ± 10%
Выходное напряжение низкого уровня при $I_{\text{вых}}^0 = 12 \text{ мA} \dots$	≤ 0,4 B
Выходное напряжение высокого уровня при $I_{\text{вых}}^1 = -0.4 \text{ мA} \dots$	≥ 2,5 B
Ток потребления при U _п = 5,5 В	≤ 30 mA
Входной ток низкого уровня	≤ -0,2 mA
Входной ток высокого уровня, выходной ток высокого	
уровня в состоянии «выключено»	≤ 20 мкА
Выходной ток низкого уровня в состоянии «выключено»	≤ -20 мкА
Выходной ток	-30 -112 мА

Предельно допустимые режимы эксплуатации

Напряжение питания	.4,55,5 B
Входное напряжение низкого уровня	.00,8 В
Входное напряжение высокого уровня	.25,5 B
Максимальное напряжение, подаваемое на выход	.5,5 B
Температура окружающей среды	10+70 °C

Общие рекомендации по применению

Безотказность работы микросхем в аппаратуре достигается: правильным выбором условий эксплуатации и электрических режимов микросхем; соблюдением последовательности монтажа микросхем в аппаратуре, исключающих тепловые, электрические и механические повреждения микросхем.

Лужение производить в следующих режимах: температура расплавленного припоя не более 260 °C; время погружения не более 2 с; расстояние от корпуса до зеркала припоя (по длине вывода) не менее 1 мм; допустимое количество погружений не более 2; интервал между двумя погружениями не менее 5 мин.

Лужение и пайка должны производиться предпочтительно припоем ПОС61 по ГОСТ 21930-76, флюсом, состоящим из 25% по массе канифоли и 75% по массе изопропилового или этилового спирта.

Установку микросхем на плату производить с зазором, который обеспечивается конструкцией выводов.

Пайку микросхем на печатную плату одножальным паяльником производить по следующему режиму: температура жала паяльника не более 270 °C; время касания каждого вывода не более 3 с; расстояние от корпуса до

места пайки (по длине вывода) не менее 1 мм; интервал между пайками соседних выводов не менее 3 с.

Жало паяльника должно быть заземлено.

Пайку микросхем на печатную плату групповым способом производить по следующему режиму: температура жала группового паяльника не более 265 °C; время воздействия этой температуры (одновременно на все выводы) не более 3 с; расстояние от корпуса до места пайки (по длине вывода) не менее 1 мм; интервал между двумя повторными пайками выводов не менее 5 мин.

Операцию очистки печатных плат с микросхемами от паяльных флюсов производить тампоном или кистью, смоченными спирто-бензиновой смесью в пропорции 1:1, ацетоном, спиртом или трихлорэтиленом, исключив при этом механическое повреждение выводов.

Сушку печатных плат с микросхемами после очистки производить при температуре не выше 60 °C.

Для влагозащиты плат с микросхемами применять лак УР-231 по ТУ 6-10-863-84 или ЭП-730 по ГОСТ 20924-81. Оптимальная толщина покрытия лаком УР231 должна быть 35...55 мкм, лаком ЭП-730 - 35...100 мкм.

Количество слоев 3.

Рекомендуемая температура сушки (полимеризации) лака 65 ± 5 °C.

Свободные входы необходимо подключать к источнику постоянного напряжения 5 В \pm 10%, к источнику выходного напряжения высокого уровня или заземлять.

Допустимое значение электростатического потенциала 200 В.